

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年5月17日(2012.5.17)

【公表番号】特表2011-525698(P2011-525698A)

【公表日】平成23年9月22日(2011.9.22)

【年通号数】公開・登録公報2011-038

【出願番号】特願2011-510606(P2011-510606)

【国際特許分類】

H 01 L	31/04	(2006.01)
B 32 B	27/34	(2006.01)
C 08 J	5/18	(2006.01)
B 32 B	27/20	(2006.01)
C 08 L	79/08	(2006.01)

【F I】

H 01 L	31/04	E
B 32 B	27/34	
C 08 J	5/18	C F G
B 32 B	27/20	Z
C 08 L	79/08	Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月26日(2012.3.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

A) ポリイミドフィルムであって

a) ポリイミドフィルムの40~95重量パーセントの量の芳香族ポリイミドであつて：

i) 少なくとも1種の芳香族二無水物であって、その少なくとも85モルパーセントが剛直性タイプ二無水物である芳香族二無水物、および

ii) 少なくとも1種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも85モルパーセントが剛直性タイプジアミンである芳香族ジアミン

から誘導されるポリイミドと

b) 充填材であつて：

i) 少なくとも1つの寸法が800ナノメートル未満であり；

ii) 3:1を超えるアスペクト比を有し；

iii) すべての寸法がポリイミドフィルムの厚さ未満であり；および

iv) ポリイミドフィルムの総重量の5~60重量パーセントの量で存在する充填材と

を含む、8~150ミクロンの厚さを有するポリイミドフィルムと、

B) 吸光体層と、

C) 前記ポリイミドフィルムによって支持されている電極であつて、吸光体層とポリイミドフィルムとの間にあり、および吸光体層と電気的に連通する電極とを備えるアセンブリ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0093

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0093】

量、濃度、または、他の値もしくはパラメータが範囲、好ましい範囲、または上方値および下方値の列挙として記載されている場合、これは、範囲が個別に開示されているかどうかに関わらず、いずれかの範囲上限または好ましい上方値と、いずれかの範囲下限または好ましい下方値とのいずれかの対から形成されるすべての範囲を特に開示していると理解されるべきである。本明細書において数値の範囲が言及されている場合、他に明記されていない限りにおいて、この範囲は、その端点、および、範囲内のすべての整数および少數を含むことが意図される。本発明の範囲が、範囲が定義される場合において特定の値に限定されることとは意図されない。

以下に、本発明の好ましい態様を示す。

[1] A) ポリイミドフィルムであって

a) ポリイミドフィルムの40～95重量パーセントの量の芳香族ポリイミドであって：

i) 少なくとも1種の芳香族二無水物であって、その少なくとも85モルパーセントが剛直性タイプ二無水物である芳香族二無水物、および

ii) 少なくとも1種の芳香族ジアミンであって、その少なくとも85モルパーセントが剛直性タイプジアミンである芳香族ジアミン

から誘導されるポリイミドと

b) 充填材であって：

i) 少なくとも1つの寸法が800ナノメートル未満であり；

ii) 3:1を超えるアスペクト比を有し；

iii) すべての寸法がポリイミドフィルムの厚さ未満であり；および

iv) ポリイミドフィルムの総重量の5～60重量パーセントの量で存在する充填材と

を含む、8～150ミクロンの厚さを有するポリイミドフィルムと、

B) 吸光体層と、

C) 前記ポリイミドフィルムによって支持されている電極であって、吸光体層とポリイミドフィルムとの間にあり、および吸光体層と電気的に連通する電極とを備えるアセンブリ。

[2] 充填材が小板、針様または纖維状であり、および吸光体層がCIGS/CIS吸光体層である、[1]に記載のアセンブリ。

[3] 充填材が針様または纖維状であり、およびアセンブリが、複数の一体集積型CIGS/CIS光起電力電池をさらに備える、[1]に記載のアセンブリ。

[4] 充填材が、少なくとも1つの寸法で600nm未満であり、およびアセンブリが、複数の一体集積型CIGS/CIS光起電力電池をさらに備える、[1]に記載のアセンブリ。

[5] 充填材が、少なくとも1つの寸法で400nm未満であり、およびアセンブリが、複数の一体集積型CIGS/CIS光起電力電池をさらに備える、[1]に記載のアセンブリ。

[6] 充填材が、少なくとも1つの寸法で200nm未満であり、およびアセンブリが、複数の一体集積型CIGS/CIS光起電力電池をさらに備える、[1]に記載のアセンブリ。

[7] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの組み合わせからなる群から選択され、およびアセンブリが、複数の一体集積型CIGS/CIS光起電力電池をさらに備える、[1]に記載のアセンブリ。

[8] 充填材が、酸素と、アルミニウム、ケイ素、チタン、マグネシウムおよびこれら

の組み合わせからなる群の少なくとも 1 種の構成要素とを含む、[1] に記載のアセンブリ。

[9] 充填材が小板タルクを含む、[1] に記載のアセンブリ。

[10] 充填材が針状の二酸化チタンを含む、[1] に記載のアセンブリ。

[11] 充填材が、その少なくとも一部が酸化アルミニウムでコートされている針状の二酸化チタンを含む、[1] に記載のアセンブリ。

[12] a) 剛直性タイプ二無水物が、3, 3', 4, 4' - ピフェニルテトラカルボン酸二無水物 (B P D A) 、ピロメリト酸二無水物 (P M D A) 、およびこれらの混合物からなる群から選択され；ならびに、

b) 剛直性タイプジアミンが、1, 4 - ジアミノベンゼン (P P D) 、4, 4' - ジアミノビフェニル、2, 2' - ビス (トリフルオロメチル) ベンジデン (T F M B) 、1, 5 - ナフタレンジアミン、1, 4 - ナフタレンジアミン、およびこれらの混合物から選択される、[1] に記載のアセンブリ。

[13] ジアミンの少なくとも 50 モルパーセントが 1, 5 - ナフタレンジアミンである、[1] に記載のアセンブリ。

[14] ポリイミドフィルムが、カップリング剤、分散剤またはこれらの組み合わせを含む、[1] に記載のアセンブリ。

[15] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが以下の特性：(i) 300 を超える T g 、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 C T E 、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および (vi) 7.4 ~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} のうち少なくとも 1 つを有する、[1] に記載のアセンブリ。

[16] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：(i) 300 を超える T g 、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 C T E 、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および (vi) 7.4 ~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} のうち少なくとも 2 つを有する、[1] に記載のアセンブリ。

[17] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：(i) 300 を超える T g 、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 C T E 、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および (vi) 7.4 ~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} のうち少なくとも 3 つを有する、[1] に記載のアセンブリ。

[18] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：(i) 300 を超える T g 、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 C T E 、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および (vi) 7.4 ~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} のうち少なくとも 4 つを有する、[1] に記載のアセンブリ。

[19] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：(i) 300 を超える T g 、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 C T E 、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および (vi) 7.4

~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} のうち少なくとも 5 つを有する、[1] に記載のアセンブリ。

[20] 充填材が、酸化物、窒化物、炭化物およびこれらの混合物からなる群から選択され、およびポリイミドフィルムが、以下の特性：(i) 300 を超える Tg、(ii) 500 ボルト / 25.4 ミクロンを超える誘電強度、(iii) 500 で 30 分間の間に不活性条件下で 1 % 未満の等温性重量損失、(iv) 25 ppm / 未満の面内 CT E、(v) $10 \times (10)^{-6}$ / 分未満の絶対値無応力残留勾配、および(vi) 7.4 ~ 8 MPa で 1 % 未満の e_{max} を有する、[1] に記載のアセンブリ。

[21] ポリイミドフィルムが 2 つ以上の層を備える、[1] に記載のアセンブリ。

[22] ポリイミドフィルムが、熱的に安定な無機物：織物、紙、シート、スクリムまたはこれらの組み合わせで強化されている、[1] に記載のアセンブリ。